

# モビリティ社会を実現するCASEへの取り組み

様々な車載製品やモバイル機器向けに設計から  
部品実装までのプリント配線板ソリューションをご提供

## 車載機器に高信頼ビルドアップ基板を

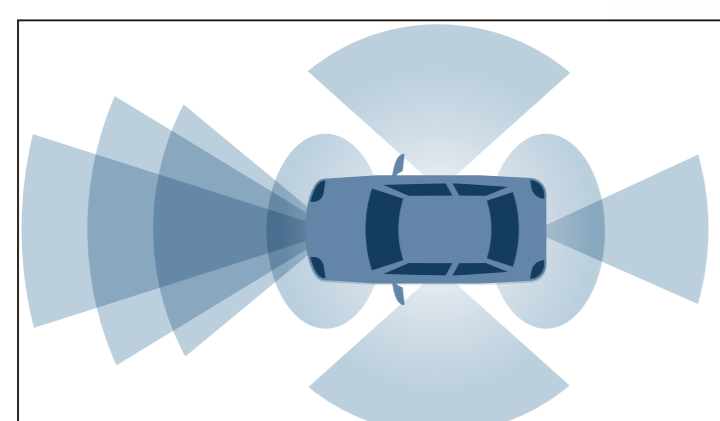
### ■ 車載向け基板量産実績



インフォテインメント



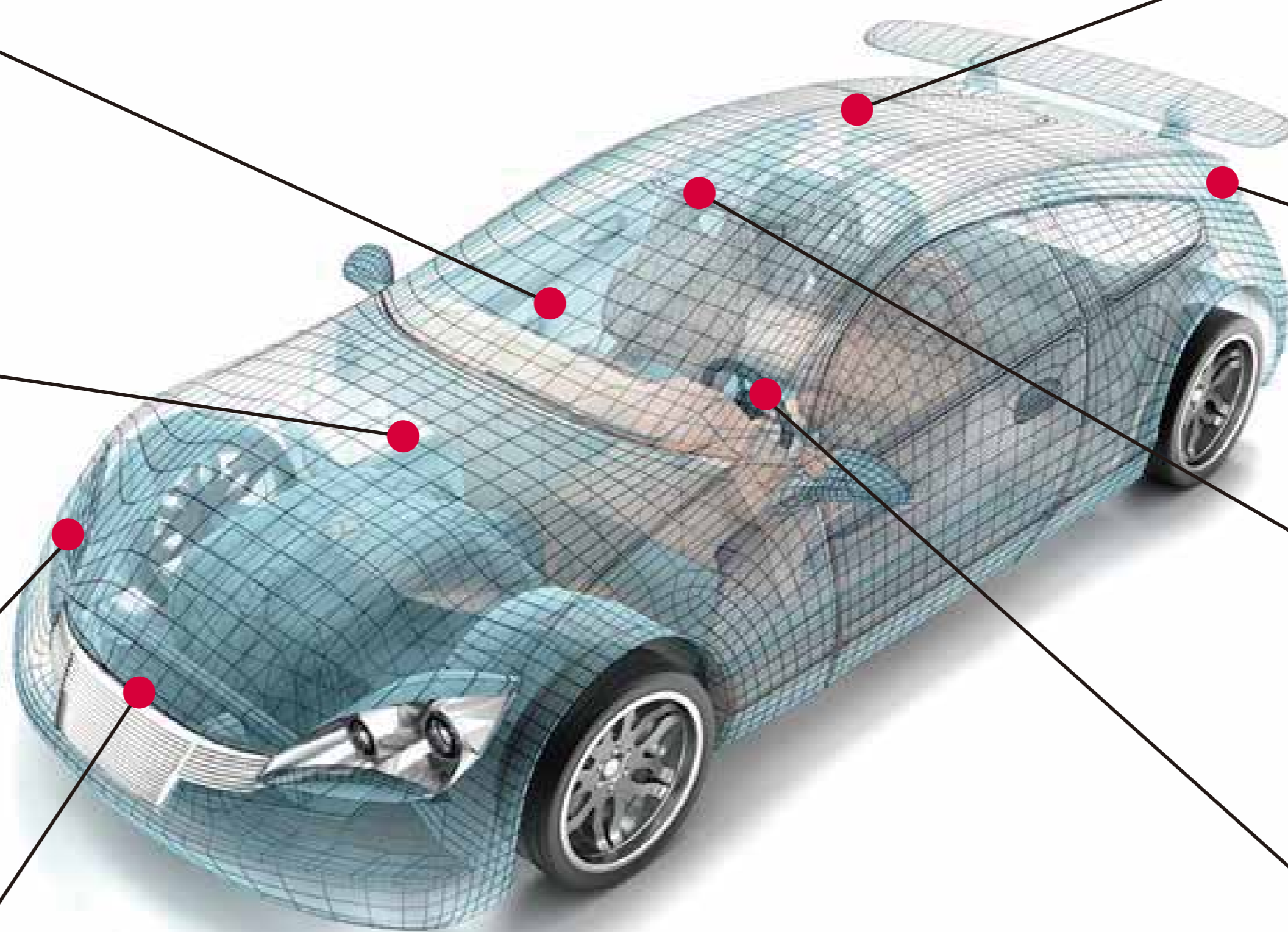
エンジン制御



アラウンドビュー



ミリ波レーダー



緊急通報システム



バックビューモニタ



ドライブレコーダ

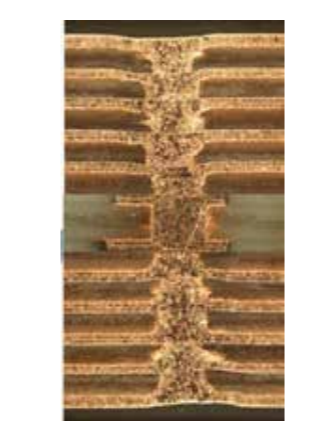


ドライブステータスマニタ/  
メーターパネル

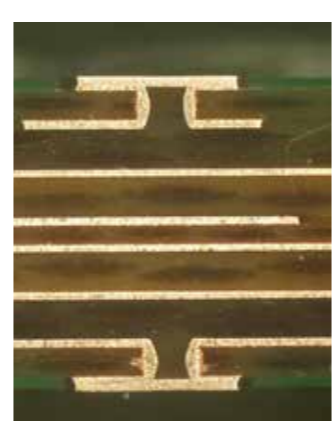
CASE: Connected Autonomous Shared & Services Electric

### ■ 多彩な車載向け多層基板構造

ビルドアップ基板	～ 5-x-5(x: 2-10)
ビアメニュー	フィールド・ビア、 スタックド・ビア
狭ピッチ化	0.3mmピッチCSP対応
板厚薄型化	0.3mm(6層)、 0.58mm(10層)対応
その他 多層基板	-貫通・貼合わせ基板で 4層～20層が対応可能 -厚銅、銅コイン、 高熱伝導材料基板 他



全層IVH基板  
12層(5-2-5)



貼合わせ基板  
8層(2+4+2)

### ■ 熱応力解析

温度サイクル時のはんだ歪み解析

